

令和 8 年 8 月 26 日

お客様・お取引先様 各位**令和 8 年熊本地震について（第三報）**

このたびの令和 8 年熊本地震により被災された皆様に、改めまして心よりお見舞い申し上げます。

また、当社グループ会社である日精電子株式会社ならびに従業員に対しまして、多くの皆様より温かいお見舞いのお言葉や支援物資をお寄せいただいておりますことに、心より厚く御礼申し上げます。皆様からのお心遣いは、復旧に取り組む従業員にとりまして大きな励みとなっております。

現在の日精電子の復旧状況につきまして、金型等の部品製造を行う工場は、設備の点検・修復を進めながら、震災前と比較して約 8 割程度まで稼働を回復しております。

プレス部品工場につきましては、被災した設備の修復および生産体制の再構築を進め、順次稼働を開始しており 9 月末までに震災前のフル稼働へ復帰することを目指して、復旧作業に全力を挙げております。

まだまだ厳しい猛暑が続く中ではありますが、日精電子の従業員一人ひとりが、お客様への影響を少しでも早く解消し、安定した生産体制を取り戻すため、それぞれの持ち場で懸命に取り組んでおります。日電精密工業グループといたしましても、引き続き全面的な支援を行い、グループ一丸となって復旧と安定供給に努めてまいります。

お客様ならびにお取引先様には、引き続きご心配、ご不便をおかけすることもございますが、一日も早い復旧に向けて全力で取り組んでまいりますので、何卒ご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

日電精密工業株式会社

日精電子株式会社

代表取締役社長 吉田圭二